



RE900-06

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP II 20, 24, 26, 28, 32 (1,27 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 26,50 x 30,94 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30